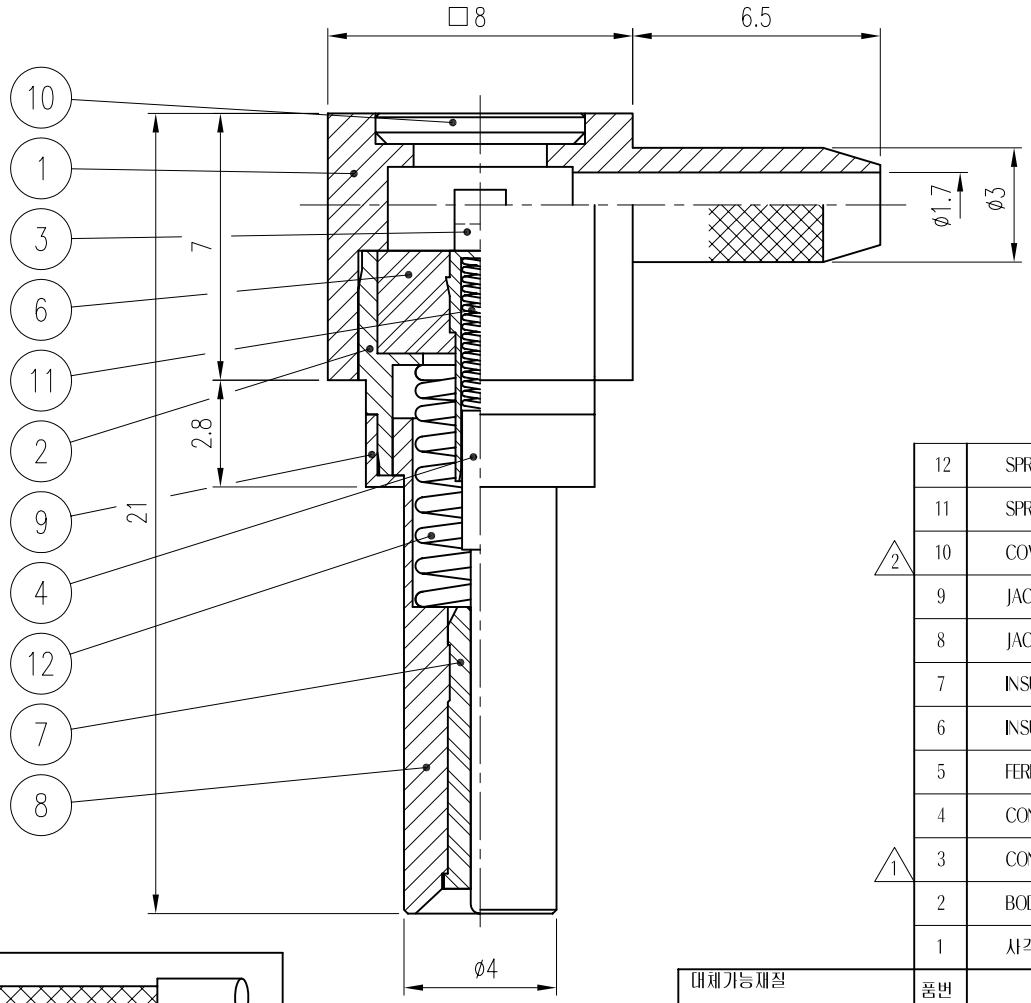
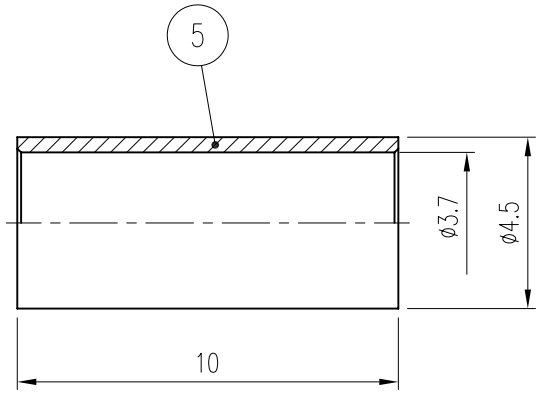
가공 / ST										
ST(기존)										
ST(개선)										

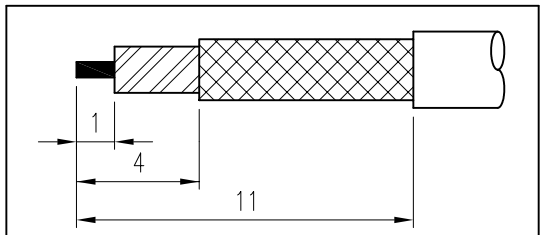
수 정 내 용

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
1	공정개선[설변처리No.연구200809-007] CABLE심선 납땜시 냉땜 발생 방지	윤상진	윤상진	2008. 09. 19.
2	공정개선[설변처리No.연구200810-0007] COVER 빠짐 방지 공차 변경	윤상진	윤상진	2008. 10. 07.





	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
	12	SPRING	1	SUS304	Gold Plate	DSR01065-N/1
	11	SPRING	1	SUS304	Nickel Plate	DSR01064-N/1
2	10	COVER	1	MBsBD	Nickel Plate	DCO00076-5/1 ~~DCO00040-5/1 (L3018)~~
	9	JACK COVER	1	MBsBD	Nickel Plate	DCO00072-5/1
	8	JACK	1	MBsBD	Gold Plate	DJA00107-5/1
	7	INSULATOR	1	TEFLON(White)		DIN01282-N/1
	6	INSULATOR	1	TEFLON(White)		DIN01281-N/1
	5	FERRULE	1	MBsBD	Nickel Plate	DFE00043-5/1 (F6007)
	4	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT01509-5/1
1	3	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT01676-5/1 ~~DCT01508-5/1~~
	2	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD01977-5/1
	1	사각 BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD01976-5/1



CABLE 탈피도

대체가능재질	년월일	2008. 5. 9.	
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	승인		
	검도		
재질	제도		
열처리	작성부서	연 구 소	
보호피막처리	척도 5/1	단위 mm	중량

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 KMS-156LP FUJIKURA VER.2

A4 도번 CN01986-7/3